

## 三菱電機 IR Day 2025 質疑応答要旨（報道機関）

日時	: 2025年5月28日（水） 10:30～15:00（12:00～13:00 は休憩）
場所	: 三菱電機株式会社 本社（オンライン説明会）
当社出席者	: （第一部） 執行役社長 CEO 漆間 啓 専務執行役 CSO 高澤 範行 専務執行役 CDO 武田 聡 常務執行役 CFO 藤本 健一郎 （第二部） ※BA：ビジネスエリア 専務執行役 インダストリー・モビリティ BA オーナー 加賀 邦彦 常務執行役 ライフ BA オーナー 尋木 保行 常務執行役 インフラ BA オーナー 根来 秀人 上席執行役員 半導体・デバイス事業本部長 竹見 政義

### <第一部：全社経営戦略説明>

- Q. 今年度中に 8,000 億円規模の課題事業に関して終息や継続の判断をするということだが、課題事業には自動車機器事業などが含まれるのか。どのような範囲で見極めを実施するのか。その事業から撤退することも選択肢として考えているのか。
- A. 自動車機器事業と FA システム事業、そしてインフラ BA 関連などが主に対象となるが、9つある事業本部の中で、それぞれが持つ事業を最適化するという観点で判断していく。課題事業の対象範囲を広げて、最適化を目指していくということである。合計 8,000 億円規模の事業の見極めをしていく中で、最終的に撤退する事業、そして継続する事業があるものと考えている。（漆間）
- Q. M&A 投資枠 1 兆円を 3 年以内に、というのは、2025 年度から 2027 年度までで 1 兆円という理解で間違いないか。具体的な用途は。
- A. 期間は 2025 年度から 2027 年度までの 3 年間で 1 兆円という理解で問題ない。用途については、説明資料（三菱電機の経営戦略）の 9 ページに記載した以上のことは現時点で具体的に決まっていない。既存事業強化や事業間シナジー創出、AI・デジタル領域の強化で考えている。（漆間）
- Q. 8,000 億円規模の課題事業の見極めをしようと考えた背景は。また、収益性や売上高など、見極めのポイントとなるものは。
- A. 当社の事業全体を俯瞰した際に、当社として今後「ありたい姿」を目指して発展していくために必要な事業かどうかという点が見極めのポイントであると考えている。世の中の趨勢を見ながら、事業を育成し価値を向上させていくことができるか、あるいはパートナーを見つけて事業をお任せしたほうが当社単独で推進するよりも最適なのではないか、という観点で見極めていく。その上で、当社が今後、循環型 デジタル・エンジニアリング企業に変革していくために必要な事業に対して、資源を集中させていきたい。（漆間）

## <第二部：各事業戦略説明>

- Q. パワーデバイス事業の成長投資を延期することだが、その要因となる市場の状況や背景は。光デバイス事業の生産能力増強にあたって、現在の生産量に対してどの程度増やすのか。また、どういったところに投資をするのか。
- A. パワーデバイスの事業環境について、再生可能エネルギーの利用拡大などに伴い電力分野の需要が堅調に推移しているが、バッテリーEVの需要が後ろ倒しとなっているほか、中国の景気後退などの影響により産業機器やルームエアコン向けのパワー半導体の需要が軟化している。従来、パワーデバイス事業は2025年度までに2,600億円の投資を考えていたが、一部の生産能力の増強に関しては延期し、その分を光デバイス事業の増産投資に充てる。光デバイス事業は2023年度から2024年度にかけて1.5倍の生産能力増強を実施しており、2024年度から2026年度にかけてさらに1.5倍の増強を考えている。その後も需要動向を見極めながらさらなる増強を適時適切に判断していく。具体的な生産量については回答を差し控える。(竹見)
- Q. 光デバイス事業の生産能力増強について、具体的にどのような形で増強するのか。また、事業構成について、高周波デバイス事業と光デバイス事業を合わせて約2割とのことだが、その中で光デバイス事業の割合は。
- A. 生産能力増強については、ウエハプロセスという半導体製造の前工程の能力増強を行う。半導体の製造においてはプロセスごとに様々な装置を使用するが、装置ごとの能力にばらつきがあるため、ボトルネックになっている装置を増強していく。光デバイス事業と高周波デバイス事業の割合については、現時点で概ね7:3程度。生産能力の増強に伴い、今後光デバイス事業の割合が高くなっていく可能性がある。(竹見)
- Q. パワーデバイス事業について、製品供給過多になっている中国市場の現状をどのように捉えているのか。現地の中国系EVメーカーでは部品の内製化や地場企業製品への置き換えなどが発生しているようだが、三菱電機としての対応は。
- A. 中国政府が現地の半導体企業に補助金を出すことで低価格化を後押ししており、中国での競争環境が激化している。当社はディスクリートではなく、高品質なモジュールを供給していくことで、中国市場だけでなく欧米や日本国内市場においてもお客様に価値を認めただけだと考える。一方で、中国の市場は非常に大きいので、コスト競争力を高めたSiCパワー半導体を供給していく。(竹見)
- Q. SiCパワー半導体のコスト競争力はウエハのコストをいかに削減するかが重要だと考えるが、その点でも中国との競争は激しいと考える。直近ではウルフスピード社が破産申請を準備していることが報道されるなど、競争環境が厳しくなっているが、今後のコスト削減の方針は。
- A. 当社は米国のCoherent社と8インチSiC基板の共同開発を進めており、当社のプロセス技術とCoherent社の基板技術をかけあわせ、より付加価値の高い製品を目指している。すでに中国企業と同等レベルのコスト競争力で、かつ高品質な製品を供給できる見込みが立っている。(竹見)
- Q. パワーデバイス事業の成長投資の延期について、具体的に何を延期するのか。また、2026年度から2030年度までの投資額は変わらないのか。パワーデバイス事業は2031年度以降に先送りで、2026年度以降も引き続き光デバイス事業への投資がメインになるのか。

- A. 2025年度までの100億円の減額については、Siパワー半導体の投資の延期がメインになる。2026年度以降の投資計画については、従来の想定から2031年度以降に一部延期を考えている。光デバイス事業に関しては2025年度までで投資をしていくが、2026年以降も需要動向を見て必要なら増額をする。(竹見)
- Q. SiCパワー半導体について、三菱電機も低価格化を進めるとのことだが、どの程度まで価格を下げれば中国企業に対抗できるのか。日本企業ではハイエンドを狙い、ローエンドは中国企業に任せるといった棲み分けが進むという業界内の見方もあるがどう考えているか。
- A. どの程度まで価格を下げるかはお答えできないが、ハイエンド領域だけを追求しても数を確保できないため、ある程度コストで勝負しなければならない領域にも対応していく必要がある。SiCパワー半導体は、まずトータルコストの中で最も高い基板のコストをCoherent社と協力して下げていく。次にウエハプロセスに関して熊本県泗水地区の新工場を省エネ化、フルオートメーション化することで製造コストを下げ、中国企業に対抗していく。一方で、低コスト領域だけを追求することは危険であり、ハイエンド領域で利益を追求していくことと併せ両面で取り組んでいく。(竹見)
- Q. ウルフスピード社が破産した場合、三菱電機にとってどのような影響が想定されるのか。
- A. 同社が申請したのは米連邦破産法第11条(チャプターイレブン)で、事業を続けるための手続きであると理解しており、現時点で当社として大きな影響は想定していないが、状況を注視していく。(竹見)
- Q. Coherent社との「連携成果の刈り取り」とは。具体的に教えてほしい
- A. Coherent社とは8インチのSiC基板の共同開発について連携している。今年9月に熊本県泗水地区の工場が竣工し、2カ月後からパイロットラインが順次稼働する。共同開発した8インチSiC基板を流すことになるため、これを「連携成果の刈り取りフェーズ」と表現している。(竹見)
- Q. Coherent社と共同開発した8インチSiC基板を他社に供給するといったことも考えられるのか
- A. 当社はSiC基板事業をやるわけではないため、当社から8インチSiC基板を他社に供給することはない。(竹見)
- Q. 三菱電機として、国産の防衛体制の増強の意義付けをどのように考えているか
- A. 当社防衛システム事業は日本の安全保障の一端を担う事業であり、抑止力につながる重要な事業と考えている。社会貢献としての側面だけでなく、事業としてしっかりと成立させ、当社の成長、技術の進歩につなげていければと考えている。(根来)
- Q. 防衛システム事業について、海外市場の見通しと競争環境をどう見ているか。また、グローバルサプライチェーンへの参画は、簡単にできるものなのか。
- A. 防衛システム事業の海外における事業戦略については大きく3つに分けて考えており、1つ目は東南アジア諸国への完成装備品移転、2つ目は欧州、オーストラリア、インドとの国際共同開発、3つ目が米国でのグローバルサプライチェーンへの参画である。今までは国内中心だったが、グローバルサプライチェーンに参画することで今後はグローバルな事業展開を強化したい。グローバルサプライチェーンへの参画は簡単ではないが、一部機種の修理などでは受注が見えつつある状況。(根来)

Q. 今年中に 8,000 億円規模の事業見極めを行うとのことだが、FA システム事業と自動車機器事業については、コアな部分は残して収益性が低いところは撤退や事業提携などを考えていくのか、事業全体も撤退の対象になるのか。

A. 自動車機器事業本部も FA システム事業本部も、その中に複数の事業を抱えている。それぞれの事業の採算性や成長性、会社としてのシナジーを考慮し、撤退を含む様々な選択肢を含めて見極め、意思決定していく。現時点で何か大きな意思決定や方向性の決定をしているわけではない。(加賀)

Q. FA システム事業の苦戦が長期化しているが、原因はどこにあると考えているのか。

A. まず、新型コロナウイルスの感染が拡大した 2020 年から 3 年間で、お客様に製品を十分に供給できなかったことで他社に後れを取り、シェアを失ったことが原因の一つ。また、2021 年からリチウムイオンバッテリー市場が急速に立ち上がった際、受注・製品供給体制を一気に整えたものの、その後、需要が大きく落ち込んだため、結果的に高コスト構造・体質になったことが原因と考えている。今後、AI など新たなテクノロジーに対応するデータセンターや半導体関連需要に対し、価値を認めていただける製品やシステムを市場に投入していきたい。FA システム事業の規模が拡大する中で、損益分岐点の管理や固定費のコントロール、コアコンポーネント以外の事業のマネジメントコストを含めて、コストコントロールできる体質に変えていかなければいけない。FA システム市場は今後さらに成長し、利益を出せる領域と考えている。(加賀)

Q. FA システム事業は、今後、競争環境としてコンポーネントは厳しい状況が続くからこそデジタルソリューションを強化しないといけないのか。あるいは、コンポーネントも反転して伸ばしていく見込みがあるのか。

A. 長期的にはコンポーネントの単品売り切りビジネスはコモディティ化していくと考えているが、今後 2、3 年で急速に進むということではなく、短期的にはコンポーネントも磨いていかなければならない。その上で、デジタル技術を活用し、当社のコンポーネントを支えるコア技術を価値に転嫁できるソリューションビジネスに変えていくことが必要だと考えている。

FA システム事業の競争環境において、中国のローカルメーカーが力をつけてきており、特にサーボは中国メーカーの台頭が著しい。機能・性能や品質を多少落としてでも安価な製品を選ぶお客様もいるが、その中で当社のラインアップが弱かったという反省がある。そこで、中国に FA システム事業の統括会社を設立し、ローカルブランドを立ち上げた。日本については高いシェアを持ち、様々なお客様との接点を持っているという強みを生かしきれていない。当社はシーケンサとサーボを組み合わせたモーションコントロール領域などに強みを持っており、それらの価値をエンドユーザーに届けるという活動にしっかり取り組んでいく。

中長期的には、各地域でコンポーネント販売を続けるだけでなく、ソフトウェアディファインド化して、クラウドなども活用しながら FA システム事業全体でソリューションを提供していく。(加賀)

以上